

国泰君安证券股份有限公司

关于

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二三年七月

国泰君安证券股份有限公司
关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书

上海证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”）接受北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“京仪装备”或“公司”）的委托，担任京仪装备首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第2号——上市保荐书内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创属性评价指引（试行）》、《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）等有关规定，保荐机构和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的本上市保荐书真实、准确和完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。

目 录

目 录	2
一、发行人基本情况	3
二、发行人本次发行情况	16
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员	16
四、保荐机构与发行人之间的关联关系	17
五、保荐机构承诺事项	18
六、保荐机构对本次发行的推荐结论	19
七、本次证券发行履行的决策程序	19
八、保荐机构关于发行人是否符合科创板定位所作出的说明	19
九、保荐机构关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 规定的上市条件的逐项说明.....	23
十、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排	28

一、发行人基本情况

（一）基本信息

公司名称	北京京仪自动化装备技术股份有限公司
英文名称	Beijing Jingyi Automation Equipment Co., Ltd.
注册资本	12,600 万元
法定代表人	李英龙
有限公司成立日期	2016 年 6 月 30 日
股份公司成立日期	2021 年 3 月 29 日
公司住所	北京市北京经济技术开发区凉水河二街 8 号院 14 号楼 A 座
邮政编码	100176
联系电话	010-58917326
传真	010-58917219
电子邮箱	zhengquanshiwubu@baecltd.com.cn
负责信息披露和投资者关系的部门	证券事务部
信息披露负责人	郑帅男
信息披露负责人电话	010-58917326
经营范围	技术推广服务；销售、维修机器人、机械设备、电气设备；货物进出口、技术进出口；生产机器人、机械设备、电气设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）主营业务

发行人主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，主营产品包括半导体专用温控设备（Chiller）、半导体专用工艺废气处理设备（Local Scrubber）和晶圆传片设备（Sorter）。公司自成立以来，主营业务未发生重大变化。

通过多年的深耕积累，公司在主要产品领域自主研发并掌握了相关核心技术，致力于为集成电路制造环节提供更高生产效率的设备。截至 2023 年 4 月 30 日，公司已获专利 200 项，其中发明专利 76 项，公司是目前国内唯一一家实现半导体专用温控设备大规模装机应用的设备制造商，也是目前国内极少数实现半导体专用工艺废气处理设备大规模装机应用的设备制造商，公司产品技术水平国内领先、国际先进。公司半导体专用温控设备产品主要用于 90nm 到

14nm 逻辑芯片以及 64 层到 192 层 3D NAND 等存储芯片制造中若干关键步骤的大规模量产；半导体专用工艺废气处理设备产品主要用于 90nm 到 28nm 逻辑芯片以及 64 层到 192 层 3D NAND 等存储芯片制造中若干关键步骤的大规模量产；晶圆传片设备产品主要用于 90nm 到 28nm 逻辑芯片制造中若干关键步骤的大规模量产。

报告期内，公司所需原材料主要包括电器装置类、电气元件类、机械标准件类、机械加工件类、化学制品类、仪器仪表类及其他等部件，公司与香河海春、万维克林、上海典熙、全谷制冷、明尼苏达矿业制造（上海）等供应商建立了长期良好且稳定的供应合作关系。

报告期内，公司主要采取以销定产与自主备货相结合的生产模式，按照客户需求进行设计、生产、调试，并采用直销的销售模式。

公司自设立以来高度重视自主创新，通过对主要产品不断迭代，持续提高设备工艺性能。公司产品已广泛用于长江存储、中芯国际、华虹集团、大连英特尔、广州粤芯、睿力集成等国内主流集成电路制造产线。公司凭借长期技术研发和工艺积累，与国际竞争对手直接竞争，持续满足客户需求。

自设立以来，公司获得北京市科学技术进步奖二等奖、北京市科学技术奖三等奖、2022 北京高精尖企业 100 强、机械工业科学技术奖（科技进步奖）三等奖、中国机械工业科学技术奖三等奖、国家级专精特新“小巨人”企业、“中国创翼”创业创新大赛北京市选拔赛一等奖、北京市企业技术中心、北京市知识产权试点单位等多项荣誉。与此同时，公司积极承担国家级重点专项研发任务，助力国内集成电路产业关键产品和技术的攻关与突破。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（三）核心技术与研发水平

1、公司核心技术

通过多年的技术研发，公司在主要产品领域自主研发掌握了相关核心技术，并在持续提高设备工艺性能、产能。截至本上市保荐书签署日，公司共拥有 13 项核心技术，公司拥有的核心技术在公司销售的产品中得以持续应用并形成公司产品的竞争力，具体情况如下：

(1) 半导体专用温控设备核心技术概况

序号	名称	技术来源	专利及其他保护措施	技术先进性及具体表征	应用和贡献情况
1	半导体温控装置制冷控制技术	自主研发	已授权发明12项，已授权实用新型4项	本技术采用喷气增焓、喷液及两级复叠制冷技术，对压缩机的喷液量精准控制。能够满足集成电路-70℃的低温温控要求，本技术增加特殊的回路设计，满足单独运行高温或低温的宽温区使用要求	大批量生产
2	半导体温控装置精密控温技术	吸收引进基础上自主研发	已授权发明38项，已授权实用新型29项	实际的半导体制程工况切换非常频繁，给半导体温控装置的控温提出很高的要求。本控制技术，在PID控制的基础上，采用串级控制思路，结合模糊控制理论对温度进行精准控制；本技术要求对压缩机频率、制冷电子膨胀阀和热气膨胀阀匹配控制，还要对系统的过热度有效控制，不但能保证制冷系统的长期稳定运行，而且要满足装置的温度在空载及带载状态下的精确控制	大批量生产
3	半导体温控装置节能技术	自主研发	已授权发明21项，已授权实用新型14项	常规温控装置采用制冷系统来实现循环介质的降温，采用加热器来实现循环介质的升温。本技术利用衍生热源发热来实现循环介质升温，并有效利用及调节压缩机的排气侧热量，压缩机采用先进变频控制，实现节能。采用两级控制思路不仅提高控制精度，在空载及带载时都保证了制冷及加热量的最小输出，减少能耗	大批量生产

(2) 半导体专用工艺废气处理设备核心技术概况

序号	名称	技术来源	专利及其他保护措施	技术先进性及具体表征	应用和贡献情况
1	低温等离子废气处理技术	自主研发	已授权发明1项，已授权实用新型5项	利用等离子电源，将氮气通过等离子火炬后形成高温等离子能量源，从而进行半导体废气处理。以氮气形成高温等离子源进行半导体废气处理，而不用天然气燃烧进行废气处理，达到先进热源使用及低碳减排的效果	大批量生产
2	新型材料防腐及密封技术	自主研发	已授权实用新型2项	气体流通核心连接部件所用到的密封材质是一种特殊经过一定比例掺杂的高分子密封材质。气体流通核心连接部件的密封材质可以有效应对半导体废气中的高温及强腐蚀性环境，保证半导体的废气不会泄漏到环境中。废气处理设备中的密封结构是在保证设备可维护性、可操作性的同时保证了设备的整体密封性	大批量生产
3	系统设计算法及原理	自主研发	已授权发明10项，已授权实用新型28项	根据废气处理量的需求进行系统的设计计算而确定设备各部分结构的尺寸及平衡系统热量。半导体废气处理设备的软件控制系统、安全控制系统，保证设备运行中的安全。本原理根据半导体的制程工艺进行不同废气处理量的产品设计，每款产品均符合半导体的 SEMI S2 安全认证	大批量生产
4	半导体废气处理纯氧燃烧技术	自主研发	已授权发明1项，已授权实用新型	在半导体废气处理的有限燃烧反应腔的空间内，利用燃气与氧气燃烧形成的高温环境进行半导体废气处理并对高温火焰状态进行实时监控，且对其燃烧产生的高温环	大批量生产

序号	名称	技术来源	专利及其他保护措施	技术先进性及具体表征	应用和贡献情况
	术		1项	境进行有效的温度控制。以燃气与纯氧气燃烧进行半导体废气处理，可以提高燃气的燃烧效率，形成的高温环境对半导体废气中的 PFC 气体的处理达到更好的处理效果	
5	Harsh 工艺除尘技术	自主研发	已授权发明6项、已授权实用新型16项	本技术为废气处理设备中设计特定的结构设计，以防止半导体工艺中的 harsh 工艺对废气处理设备的进气管路、腔体等形成堵塞，延长维护周期。在进气管路端出口、反应腔内部、洗涤塔内部进行特定结构设计，防止粉尘堵塞设备，延长设备的维护周期	大批量生产

(3) 晶圆传片设备核心技术概况

序号	名称	技术来源	专利及其他保护措施	技术先进性及具体表征	应用和贡献情况
1	半导体晶圆传控技术	自主研发	已授权发明1项，已授权实用新型2项	建立晶圆传送路径流程图，通过运动控制单元完成运动学正逆解算法、运动轨迹规划、多轴协同运动控制算法和抑振控制，实现晶圆高速、可靠、超洁净度的传片倒片，实现双臂 R-θ 的节拍控制	大批量生产
2	晶圆翻片技术	自主研发	已授权发明1项	翻转机构的晶圆位置监测系统利用多组传感器，对翻片的各个状态进行监测，实现翻转机构的稳定运行	大批量生产
3	X-θ 自动寻心算法	吸收引进基础上自主研发	已授权实用新型2项	使用机械手集成的寻心传感器抓取晶圆边沿的三个点的平面坐标，根据三个点的坐标计算出圆心的位置。本算法不需要增加额外的预对准装置，提高了设备的集成度	大批量生产
4	微晶背接触传控技术	自主研发	已授权发明3项、已授权实用新型3项	通过摩擦力实现晶圆的传输，通过运动控制实现晶圆的平稳传输	大批量生产
5	晶圆区域检测技术	自主研发	已授权发明3项、已授权实用新型2项	通过在机械手末端增加传感器，检测晶圆的偏移，一旦晶圆偏移超过传感器限定的区域，机械手停止运行防止晶圆掉落；通过在 θ 轴上安装区域检测传感器，可以检测到晶圆是否已经运行到物料盒的区域，如果实际晶圆位置所计算的区域和传感器对应的区域有偏差，则需要停机进行检查，防止晶圆发生意外的碰撞	大批量生产

2、公司获得的重要奖项

2016年成立至今，公司获得北京市人民政府、中国机械工业联合会、中国机械工程学会、工业和信息化部、北京市知识产权局、北京市经济和信息化局等单位颁发的多项重要奖项、荣誉，具体情况如下：

序号	所获奖项	鉴定/颁奖单位	获奖时间
1	北京市科学技术进步奖二等奖	北京市人民政府	2022年11月
2	北京市科学技术奖三等奖	北京市人民政府	2018年11月

序号	所获奖项	鉴定/颁奖单位	获奖时间
3	2022 北京高精尖企业 100 强	北京企业联合会，北京市企业家协会	2022 年 12 月
4	机械工业科学技术奖（科技进步奖）三等奖	中国机械工业联合会，中国机械工程学会	2022 年 10 月
5	中国机械工业科学技术奖三等奖	中国机械工业联合会，中国机械工程学会	2018 年 10 月
6	国家级专精特新“小巨人”企业（2021 年 7 月-2024 年 7 月）	工业和信息化部	2021 年 7 月
7	北京市市级“企业技术中心”	北京市经济和信息化局	2021 年 11 月
8	2020-2022 年度北京市知识产权试点单位	北京市知识产权局	2020 年 9 月
9	“中国创翼”创业创新大赛北京市选拔赛一等奖	第四届“中国创翼”创业创新大赛北京市选拔赛暨第三届“创业北京”创业创新大赛组委会	2020 年 8 月
10	第二十一届中国北京国际科技产业博览会最佳展示奖	中国北京国际科技产业博览会组委会办公室	2018 年 7 月

3、公司承担的重大科研项目

报告期内，公司承担的国家级重大科研项目情况如下：

序号	项目类别	重大科研项目名称	项目实施周期
1	国家级重大项目/课题	国家级重大专项课题（温控装置相关）	2022 年 1 月至 2024 年 12 月

4、正在从事的主要研发项目情况

截至本上市保荐书签署日，公司正在从事的主要研发项目如下：

序号	研发项目名称	拟达目标	阶段及进展情况
1	集成电路制造新一代节能及多通道温控装备技术	在现有产品基础上优化产品能耗、温度控制区间，研发新一代半导体专用节能温控装备及多通道温控装备	研究阶段 形成样机
2	集成电路制造温控装备信息采集及智慧化调测系统	研发半导体专用温控装备的信息采集及智慧化调测系统，提升产品调测效率，增强大批量现场装机机台的智慧化管理。同时，将开发的新技术、新产品快速应用于已售产品，进行器件、技术升级，延长 Chiller 产品生命周期，提高市场竞争力	研究阶段

序号	研发项目名称	拟达目标	阶段及进展情况
3	集成电路制造温控装备前沿技术探究及产品研发	研发低温-40℃以内切换及混合温控产品、超低温-120℃预研及大流量、大负载 Chiller、新型热交换器系列产品等，满足产品迭代需求	研究阶段 形成样机
4	集成电路专用超低温温控装置研发及产业化	主力研发-40℃至-120℃超低温产品，涵盖超低温样机、混合工质、超低温控制算法、超低温载冷剂、超低温保温技术以及针对低温产品测试专用平台等方面的技术与产业化	研究阶段 形成样机
5	半导体温控装备产品技术创新迭代及新品部技术设计开发及验证	研究针对既有产品进行新品部部件开发与验证；产品技术迭代及创新；模块化设计及效率提升、质量提升；成本优化、环保优化	研究阶段
6	半导体工艺气体热反应处理装备持续升级优化及研究	持续研发升级半导体专用工艺废气处理设备，解决多粉尘工艺应用过程中反应腔堵塞严重、进气管路堵塞等问题，延长产品及零部件使用寿命	研究阶段 形成样机
7	新一代半导体工艺气体热反应处理装备及研究	针对现有产品研发新一代半导体专用工艺废气处理设备，提升废气处理效率以及处理量，实现各个系统模块化设计及标准化设计，优化设备布局结构	研究阶段
8	集成电路 X-θ 洁净机械人传控技术平台研究及产品开发	通过研发新运动控制平台、升级寻心算法、开发新运动控制卡程序等完善晶圆传片设备产品	研究阶段 形成样机
9	集成电路 R-θ 洁净机械人传控技术平台研究及产品开发	开发和应用 R-θ 洁净机械手，优化电控系统，研发新运动控制平台，开发和完善 G3 系列晶圆传控设备	研究阶段 形成样机

(四) 主要经营和财务数据及指标

项目	2022 年末/ 2022 年度	2021 年末/ 2021 年度	2020 年末/ 2020 年度
资产总额（万元）	131,937.72	90,384.27	44,466.77
归属于母公司所有者权益（万元）	54,834.86	45,699.50	24,776.66
资产负债率（母公司）	60.82%	50.05%	49.81%
资产负债率（合并）	58.44%	49.44%	44.28%
营业收入（万元）	66,372.32	50,137.21	34,879.78
净利润（万元）	9,111.89	5,880.41	633.11
归属于母公司所有者的净利润（万元）	9,111.89	5,880.41	633.11
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	8,202.21	5,490.21	94.99

项目	2022 年末/ 2022 年度	2021 年末/ 2021 年度	2020 年末/ 2020 年度
基本每股收益（元）	0.72	0.49	-
稀释每股收益（元）	0.72	0.49	-
加权平均净资产收益率	18.13%	21.20%	6.23%
经营活动产生的现金流量净额 （万元）	335.64	2,234.19	-10,577.28
现金分红（万元）	-	-	-
研发投入占营业收入的比例	7.29%	6.55%	6.81%

（五）主要风险

1、与发行人有关的风险

（1）经营风险

1) 技术升级迭代的风险

公司所处的半导体设备行业属于技术密集型行业，半导体设备的研发涉及微电子、电气、机械、材料、化学工程、流体力学、自动化、通讯、软件系统等众多学科领域，具有较高的技术研发门槛。随着全球半导体行业的蓬勃发展，半导体行业技术日新月异，产品性能需不断更新迭代。如果公司不能紧跟国内外半导体设备制造技术的发展趋势，不能保证持续的资金投入，持续加强技术研发和技术人才队伍的建设，可能导致公司无法实现技术水平的提升，在未来的市场竞争中处于劣势，届时公司将面临因无法保持持续创新能力而导致市场竞争力下降的风险。

2) 客户集中的风险

报告期各期，公司前五大客户的销售收入合计分别为 29,636.66 万元、44,003.76 万元和 48,742.42 万元，占同期营业收入的比例分别为 84.97%、87.77% 和 73.44%。公司客户集中度较高，主要受客户所在下游行业集中度高的影响。如果公司主要客户生产经营情况恶化、资本性支出下降，导致其向公司下达的订单数量下降，则可能对公司的业绩稳定性产生影响。此外，如果公司无法维护与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户资源并转化为收入，亦将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

3) 核心研发人员流失或不足的风险

技术人才是决定半导体设备行业竞争力的关键因素。伴随市场需求的不断增长和行业竞争的日益激烈，行业对于专业技术人才的竞争不断加剧。如果未来公司不能提供更好的发展平台、更具市场竞争力的薪酬待遇及良好的研发条件，可能面临核心研发人员流失的风险；同时，随着公司募集资金投资项目的实施，公司资产和经营规模将迅速扩张，若公司人才不能满足营业规模增长和持续技术研发的需求，公司将面临核心研发人员流失或不足的风险。

4) 核心技术泄密的风险

作为技术密集型行业，核心技术系公司核心竞争力的体现。经过多年的研发投入和技术创新，公司已形成多项核心技术，并广泛应用于相关产品的研发、制造等活动中。由于技术保护措施的局限性，若公司在经营过程中核心技术被不当泄露并被竞争对手掌握，可能给公司已建立的技术优势及市场竞争力带来不利影响，进而影响公司的盈利能力。

(2) 财务风险

1) 收入增速放缓甚至业绩下滑的风险

报告期各期，公司的营业收入分别为 34,879.78 万元、50,137.21 万元和 66,372.32 万元。2023 年 1-6 月公司经审阅的营业收入为 43,444.66 万元，同比增幅 10.93%，增幅低于报告期内营业收入复合增长率。

半导体行业的发展与宏观经济整体发展密切相关，消费电子需求走弱等下游终端应用需求疲软因素导致部分客户扩产节奏调整、经营业绩有所下滑。另外，近期受国际环境变化影响，客户现场部分国外供应的瓶颈机台存在交付延迟的情况，导致产线建设进度较慢，对应公司半导体专用设备的平均验收周期有所延长，公司期末发出商品规模持续增加。

如果未来发生宏观经济景气度下行、半导体产业的国际环境进一步恶化、主要客户削减资本开支、行业竞争加剧和技术迭代更新而公司未能及时推出符合市场需求的产品等情形，可能导致公司面临较大的经营压力，新签订单规模可能下滑，半导体专用设备的验收周期可能进一步延长，期末发出商品规模可能持续增加，存在市场开拓不及预期和收入增速持续放缓甚至业绩下滑的风险。

2) 经营活动现金流量净额为负的风险

报告期各期，公司经营活动现金流量净额分别为-10,577.28万元、2,234.19万元和335.64万元，2020年度公司经营活动现金流量净额为负，公司对日常营运资金的需求随生产经营规模扩大而不断提升。如果公司无法按时向客户收回款项或筹资活动受到限制，可能导致公司面临一定流动性风险。

3) 毛利率波动风险

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为29.56%、38.03%和39.98%，逐年增长，其中半导体专用温控设备的毛利率分别为28.26%、35.84%和43.17%。如果未来公司无法进一步提升自身创新能力并保持技术实力的领先地位，或者行业竞争加剧导致产品价格下降，亦或者公司无法有效控制产品成本，都可能导致公司毛利率发生波动，给公司的经营带来一定风险。

4) 应收账款坏账风险

随着公司营业收入规模的不断增长，公司应收账款规模整体呈现增长趋势。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为14,811.28万元、18,748.02万元和20,112.41万元，占流动资产的比例分别为36.22%、22.06%和16.13%。如果未来宏观经济形势下行或客户经营情况发生不利变化，公司可能面临应收账款无法收回导致的坏账损失风险。

5) 存货跌价风险

随着公司生产经营规模的不断扩大，公司存货规模整体呈现增长趋势。报告期各期末，公司存货账面价值分别为14,899.14万元、36,437.48万元和69,913.50万元，占流动资产的比例分别为36.44%、42.87%和56.08%。公司半导体专用设备产品交付后，通常需要安装调试并运行一段时间后完成客户验收。报告期各期末，公司发出商品账面价值分别为3,875.11万元、19,372.33万元和37,460.41万元，占各期末存货账面价值的比例分别为26.01%、53.17%和53.58%。如果未来产品销售价格发生重大不利变化或者市场需求发生变化导致产成品无法顺利实现销售，或发出商品无法顺利通过客户验收，公司可能面临存货跌价风险。

(3) 内控和法律风险

1) 公司规模扩张带来的管理和内控风险

随着资产、业务、人员规模快速增长，公司在研发、采购、生产、销售等环节上的资源配置和内控管理的复杂度也相应提升，从而对经营管理能力提出了更高要求。若公司经营管理水平无法适应业务规模的快速扩张，或公司组织架构和管理制度未能及时调整完善或运行情况不佳，将可能导致公司运营效率和内控水平有所下降，对公司持续稳定发展造成不利影响。

2) 对境外子公司的管控风险

公司在日本设有全资子公司，如果公司无法适应国外的监管环境、市场环境，或出现境内外经营理念的偏差，导致公司无法持续执行有效的境外子公司管控体系，可能对公司的生产经营产生不利影响。

3) 知识产权争议风险

半导体设备行业是典型的技术密集型行业，为了保持技术优势和竞争力，防止技术外泄风险，已掌握先进技术的半导体设备企业通常会通过申请专利等方式设置较高的进入壁垒。专利、商标等知识产权保护与侵权风险可能会随着公司产品线的不断丰富而增加，届时可能需要通过法律诉讼等方式维护自身权益，由此带来较高的法律和经济成本，将对公司的生产经营造成不利影响。此外，公司供应商和客户的日常经营也可能受知识产权争议、诉讼等因素影响，进而间接影响公司正常的生产经营。

4) 房屋租赁可能产生的风险

截至本上市保荐书签署日，公司主要通过租赁取得经营场所。若出租方在租赁期满前提前终止租赁合同，或公司在租赁期满后不能通过续租、自建等途径解决后续生产场地及厂房问题，将使公司及子公司的生产场地面临被动搬迁的风险，从而对生产经营产生不利影响。

公司子公司安徽京仪向芜湖经济技术开发区建设投资公司租赁江北集中区科技孵化园 9 号厂房、12 号厂房，但该等厂房权属手续尚未办理完毕。若出租方因房屋产权手续等事项受到处罚进而影响安徽京仪使用该等厂房，将对安徽京仪生产经营产生不利影响。

5) 发行人境外子公司所在司法辖区相关法律变化的风险

公司于日本设有全资子公司。如果子公司未能及时或完全遵守相关地区发布或更新的相关法律法规，则可能面临相应的法律风险，从而对公司的生产经营和财务状况造成不利影响。

6) 产品和服务质量纠纷的风险

公司产品具有高度复杂性，产品生产周期长、管理难度大，不排除由于不可抗力因素、操作不当及其他原因导致公司提供的产品和服务出现质量未能达到客户预期的情况，导致公司面临质保维修成本较高、与客户发生产品和服务质量纠纷的风险，进而对公司的生产经营和行业声誉产生一定的不利影响。

2、与行业相关的风险

(1) 贸易摩擦与地缘政治矛盾导致的经营风险

公司部分原材料采购自美国、日本等国家和地区的供应商或其境内代理商，报告期各期境外原材料采购金额占原材料采购金额比例分别为 35.64%、43.09% 和 39.46%，如果供应商所在国出台相关贸易限制性政策，构建贸易壁垒，使得相关原材料出现价格上涨、供应短缺或供应中断的情况，公司将面临采购成本上升、供应链稳定性受到影响等风险，从而对公司经营发展产生一定的不利影响。

随着国际贸易摩擦、地缘政治矛盾加剧，部分国家采用包括但不限于提高关税、限制进出口、列入“实体清单”等多种方式或者制裁措施实行贸易保护主义。上述境外制裁可能导致公司下游客户现有产线维护、新产线扩张、未来技术升级等受到不利影响，进而导致下游客户需求或者订单产生不利波动。客户产线建设进度放缓，可能导致公司相应订单交付计划有所调整、新签订单规模下降、产品验收周期拉长，进而影响公司采购和生产安排，导致公司业绩增速放缓，对公司财务状况和经营业绩带来一定的不利影响。客户先进制程产线建设进度和技术升级受阻，可能影响公司产品在先进制程产线的经验积累和技术更新，从而对公司业务发展产生一定的不利影响。

不排除因国际贸易摩擦、地缘政治矛盾的升级，国内半导体产业链上下游企业，包括集成电路制造企业、半导体产业设备、材料、零部件企业等，受到

境外国家或境外组织采取限制措施，使得国内半导体产业发展面临境外制裁加剧的风险。该等境外制裁可能对公司生产经营带来不利影响。

（2）市场竞争风险

全球半导体专用设备行业竞争激烈，市场主要被国际巨头企业所占据。目前，全球半导体专用温控设备、半导体专用工艺废气处理设备及晶圆切片设备市场由少数国际厂商占据主导地位，公司在经营规模、市场地位等方面存在一定劣势。公司所处行业面临较强的竞争：市场地位方面，国外厂商具有较强的技术实力、市场份额，集成电路制造企业在采购设备时仍会考虑既有行业龙头企业的产品，存在一定粘性。经营规模方面，国外龙头企业成立时间较早，具备大规模生产经营的能力并实现了多业务协同、形成多条业务线，先发优势明显，而公司目前尚处于发展阶段，经营规模上存在一定劣势。产品应用方面，国外厂商在各类工艺环节及境外晶圆制造产线拥有较为丰富的应用经验，公司在部分工艺环节及境外晶圆制造产线的产品应用经验有待提升。同时，随着我国政策的大力支持，国内企业也逐渐加入到该行业中参与竞争。未来公司将面临着国际知名企业以及国内企业的竞争压力和市场竞争风险。如果公司产品技术水平及主要技术指标无法持续满足下游客户需求或者与竞品存在较大差距，公司将面临较大的市场竞争压力。如果公司不能在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力、持续满足下游市场对产品性能指标的要求，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位、经营业绩出现下滑。

（3）行业政策变动风险

半导体技术的发展及广泛应用极大推动了科学技术进步和社会经济发展，成为国家重点支持的行业。近年来，国家相关部委出台了一系列鼓励和支持半导体行业发展的政策，为半导体及其专用设备制造行业发展提供了财政、税收、技术和人才等多方面的有力支持。随着外部环境的变化，若未来公司所处行业国家政策或支持力度发生变化，公司不能及时调整以适应行业政策的变化，将会对公司的生产经营活动产生不利影响。

（4）下游行业市场需求降低风险

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，而半导体专用设备市场的发展主要受下游半导体制造市场推动，该类设备的需求会随着晶圆厂产线建设加快和设备投资支出的增长而增长。如果未来下游半导体的终端需求有所减弱，行业景气度下降，导致下游客户削减资本性支出，将会减少半导体设备行业的市场需求，从而对公司的持续发展产生不利影响。

（5）税收优惠政策变化风险

报告期内，公司及子公司安徽京仪享受高新技术企业所得税税收优惠以及增值税即征即退税收优惠。报告期各期，公司享受的税收优惠金额分别为 968.99 万元、1,122.22 万元和 3,335.51 万元，占当期利润总额的比例分别为 112.82%、17.03%和 33.03%。若未来国家税收优惠政策发生不利变化，或公司及安徽京仪未能通过高新技术企业资格重新认定，将会导致公司承担的税负成本增加，进而对公司利润水平造成不利影响。

3、其他风险

（1）募集资金投资项目未能实现预期经济效益风险

本次发行的募集资金投资项目包括集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目和补充流动资金。本次募集资金投资项目虽然经过了可行性论证和市场研究，但该等论证和研究均系基于当前市场环境、技术能力和发展趋势等因素作出的。在项目实际实施的过程中，可能会面临整体经济形势、行业市场环境、技术革新等不确定因素，以及在研发过程中未能实现关键技术的突破，或研发的产品性能无法达到预期，将会对公司募集资金投资项目的实施带来不利影响。

（2）募集资金到位后公司即期回报被摊薄的风险

本次发行后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产都将会有一定幅度的增加，但本次募集资金投资项目需要经历一定时间的建设和培育，投资效益不能立即体现，短期内可能对公司业绩增长贡献较小。本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。

二、发行人本次发行情况

证券种类	人民币普通股（A股）
发行股数、占发行后总股本的比例	本次公开发行股票数量不超过 4,200 万股，占发行后公司股份总数的比例不低于 25.00%
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上海证券交易所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上海证券交易所提交相关文件
发行方式	采取向战略投资者定向配售、网下向询价对象配售发行与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会/上海证券交易所认可的其他方式
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易所股票账户的符合相关法律法规关于科创板股票投资者适当性条件的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会、上海证券交易所规定的其他对象
承销方式	余额包销

三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员

（一）保荐机构和保荐代表人、项目协办人的联系方式

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

保荐代表人：姚涛、黄祥

项目协办人：付雨点

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

电话：010-83939204

传真：010-83939204

（二）具体负责本次推荐的保荐代表人

国泰君安指定姚涛、黄祥为本次证券发行的保荐代表人。

姚涛先生：法学硕士，保荐代表人、非执业注册会计师，曾主持或参与北京元六鸿远电子科技股份有限公司 IPO、北京元隆雅图文化传播股份有限公司 IPO、中盐内蒙古化工股份有限公司重大资产重组、国投资本股份有限公司非公开发行股票、鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券、金徽酒股

份有限公司非公开发行股票等项目，姚涛先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

黄祥先生：管理学学士，保荐代表人、非执业注册会计师，曾主持或参与锦州神工半导体股份有限公司科创板 IPO、北京先进数通信息技术股份公司 IPO、北京元六鸿远电子科技股份有限公司 IPO、北京元隆雅图文化传播股份有限公司 IPO、河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票等项目，黄祥先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

（三）项目协办人及其他项目组成员

国泰君安指定付雨点为本次发行的项目协办人，项目组其他成员包括曹大勇、耿嘉成、景观、张琦、武丁、杨易、刘崇然、罗威。

四、保荐机构与发行人之间的关联关系

（一）截至本上市保荐书签署日，本次发行的保荐机构（主承销商）国泰君安安全子公司国泰君安证裕投资有限公司拟参与本次发行战略配售。截至本上市保荐书签署日，公司股东海丝民合、国丰鼎嘉、宁波先达、中小企业基金等私募基金穿透后存在国泰君安相关的投资，国泰君安间接持有公司股份的比例合计约为低于 0.1%。上述间接持股比例较低，是国泰君安控制的国泰君安创新投资有限公司、国泰君安证裕投资有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司等相关投资主体或金融产品管理人依据市场化原则进行的投资。

除上述情形外，保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在其他持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）截至本上市保荐书签署日，不存在发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）截至本上市保荐书签署日，不存在保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

（四）截至本上市保荐书签署日，不存在保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）截至本上市保荐书签署日，不存在保荐机构与发行人之间的其他关联关系。

五、保荐机构承诺事项

（一）保荐机构对本次上市保荐的一般承诺

保荐机构根据法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，对发行人及其直接控股股东、间接控股股东、实际控制人和其他主要股东进行了尽职调查和审慎核查。根据发行人的委托，保荐机构组织编制了本次公开发行股票申请文件，同意推荐发行人本次证券发行上市，并据此出具本上市保荐书。

（二）保荐机构对本次上市保荐的逐项承诺

保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所等有关规定对发行人进行了充分的尽职调查和辅导，保荐机构有充分理由确信发行人至少符合下列要求：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会和上海证券交易所有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证本上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、中国证监会规定的其他事项。

六、保荐机构对本次发行的推荐结论

在充分尽职调查、审慎核查的基础上，保荐机构认为，京仪装备首次公开发行股票并在科创板上市符合《公司法》、《证券法》、《注册办法》、《保荐业务管理办法》等法律、法规和规范性文件中有关首次公开发行股票并在科创板上市的条件，同意推荐京仪装备本次证券发行上市。

七、本次证券发行履行的决策程序

经核查，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所有关规定的决策程序，具体如下：

2022年10月8日，发行人召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的方案的议案》等与本次发行上市相关的议案，并决定将上述相关议案提请发行人2022年第二次临时股东大会审议。2022年10月25日，发行人召开了2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。

八、保荐机构关于发行人是否符合科创板定位所作出的说明

（一）发行人技术先进性的核查情况

保荐机构查阅了发行人所在行业领域的相关专业教材、行业研究报告、市场分析报告、同行业公司的公开资料，访谈了发行人的管理层、核心技术人员、主要客户，核查了发行人报告期内产品销售情况，查阅了发行人开展研发项目

的相关文件，取得了发行人的专利证书、软件著作权登记证书以及发行人获得的奖项证书。

经核查，在核心技术及其功能性能方面，发行人通过自主研发在半导体专用温控设备、半导体专用工艺废气处理设备和晶圆传片设备方面形成了核心技术体系，运用核心技术生产的产品是国家相关产业政策重点发展的半导体专用设备，产品技术指标满足半导体晶圆制造产业发展要求，总体技术水平达到国内领先、国际先进水平；在取得的研发进展及其成果方面，发行人在报告期内研发形成半导体温控装置制冷控制技术、半导体温控装置精密控温技术、半导体温控装置节能技术、低温等离子废气处理技术、半导体晶圆传控技术等核心技术，形成了专利、软件著作权等技术成果，并通过研发丰富了产品种类；在承担研发任务方面，发行人承担了国家级重点专项研发任务；在获得的奖项方面，发行人报告期内获得了多项省市级科技创新奖项。

基于上述，保荐机构认为，发行人依靠自主研发在半导体专用温控设备、半导体专用工艺废气处理设备和晶圆传片设备方面构建了核心技术体系，形成了专利、软件著作权等技术成果，承担了国家级重点专项研发任务，获得了省市级的科技创新奖项，并不断开发出满足半导体晶圆制造产业发展要求以及下游市场客户需求的半导体专用设备，总体技术水平达到国内领先、国际先进水平。

（二）发行人符合科创板支持方向的核查情况

保荐机构查询了发行人所在行业的国家产业政策，查阅了相关行业领域的专业教材、行业研究报告、市场分析报告、同行业公司的公开资料，访谈了发行人的管理层、核心技术人员、主要客户，核查了发行人报告期内产品销售情况，取得了发行人核心技术人员的简历，核查了发行人报告期内研发投入情况，查阅了发行人的产品规格书以及同行业公司的产品介绍。

经核查，在符合国家科技创新战略相关要求方面，发行人主营业务符合国家“十四五”规划、《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》等产业政策鼓励方向，主要产品半导体专用温控设备、半导体专用工艺废气处理设备和晶圆传片设备为

近年来国家多项产业政策重点发展的半导体专用设备；在先进技术应用形成的产品以及产业化情况方面，发行人在报告期内应用先进技术研发、设计、生产形成的产品已实现产业化；在核心技术人员的科研能力和研发投入情况方面，发行人核心技术人员的科研能力较强，最近三年持续进行研发投入，具有保持技术先进性的持续研发能力；在境内与境外发展水平中所处的位置情况方面，发行人在总体技术达到国内领先、国际先进水平，主要产品技术指标达到国内领先、国际先进水平；在保持技术不断创新的机制安排和技术储备、市场认可程度等情况方面，发行人建立了保持技术不断创新的机制和安排，重视对核心员工的激励，持续强化技术储备，产品技术水平获得了包括长江存储、中芯国际、华虹集团、大连英特尔、广州粤芯、睿力集成在内等国内主流集成电路制造产线，市场认可程度较高。

基于上述，保荐机构认为，发行人符合国家科技创新战略，先进技术应用形成的产品已实现产业化，核心技术人员的科研能力较强并持续进行研发投入，主要产品技术指标达到国际领先企业的同类产品水平，总体技术达到国内领先、国际先进水平，并建立了保持技术不断创新的机制，市场认可度较高，符合科创板优先支持方向。

（三）发行人符合科创板行业领域的核查要求

保荐机构根据国家相关权威产业分类目录、规划或指南的规定，结合发行人同行业可比上市公司行业分类情况，核查了发行人所属行业领域情况。

经核查，发行人主营业务为半导体专用温控设备、半导体专用工艺废气处理设备和晶圆传片设备的研发、设计、生产和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“专用设备制造业”（行业代码：C35）中的“电子和电工机械专用设备制造”（行业代码：C356）中的“半导体器件专用设备制造”（行业代码：C3562）。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造-3562*半导体器件专用设备制造”，属于《重点产品与服务目录》中的“集成电路生产线设备。公司所在行业属于科创板重点推荐的“新一代信息技术”之“半导体和集成电路”行业领域，符合科创板行业领域要求。

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，发行人所处行业属于制造业下“C35 专用设备制造业”。发行人同行业可比上市公司北方华创、中微公司、芯源微、华海清科、至纯科技、盛剑环境等所处行业均为《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)规定的“专用设备制造业(行业代码：C35)”，其中科创板上市公司中微公司、芯源微、华海清科所处行业属于《战略性新兴产业分类(2018)》规定的“新一代信息技术领域”。基于上述，保荐机构认为，发行人主营业务与所属行业领域归类匹配，与可比公司行业领域归类不存在显著差异。

(四) 发行人符合科创属性要求的核查情况

根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》《科创属性评价指引(试行)》，公司同时符合科创属性4项指标要求：

科创属性评价标准	是否符合	发行人符合情况
最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例 5% 以上，或最近三年研发投入金额累计在 6,000 万元以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司最近三年累计研发投入为 10,498.62 万元，占最近三年累计营业收入比例为 6.93%
研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至 2022 年 12 月 31 日，公司研发人员占当年员工总数的比例为 20.05%
应用于公司主营业务的发明专利 5 项以上	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至 2023 年 4 月 30 日，公司应用于主营业务的发明专利 76 项
最近三年营业收入复合增长率达到 20%，或最近一年营业收入金额达到 3 亿元	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2020 年-2022 年，公司营业收入复合增长率为 37.95%；2022 年度公司营业收入 6.64 亿元

1、保荐机构查阅了发行人研发投入、营业收入确认相关的内部控制制度，访谈了发行人管理层、财务负责人及技术研发部门负责人，访谈并函证了发行人主要客户，查验了研发项目相关的管理系统、过程记录文件，核查了研发投入归集及营业收入确认相关的会计记录及会计凭证，对相关内部控制制度的有效性进行了测试，查阅了发行人会计师出具的审计报告。经核查，发行人研发投入及营业收入确认相关的内部控制制度健全且被有效执行，报告期内研发投入归集及营业收入确认准确。基于上述，保荐机构认为，发行人最近三年累计研发投入及占最近三年累计营业收入的比例真实、准确，符合最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例 5% 以上的指标。

2、保荐机构查阅了发行人员工名册、研发项目文件、研发人员工时记录，访谈了发行人管理层及技术研发部门负责人，了解了发行人研发人员占比的计算基础及计算方法。经核查，发行人研发人员认定准确，研发人员占员工总数的计算方法合理。基于上述，保荐机构认为，发行人符合研发人员占当年员工总数的比例不低于 10% 的指标。

3、保荐机构访谈了发行人管理层及技术研发部门负责人，查阅了发行人取得的专利证书，取得了国家知识产权局专利登记簿副本，查询了国家知识产权局网站公开信息，查阅了发行人律师出具的法律意见。经核查，发行人列报的发明专利主要为发行人或其全资子公司通过自主申请方式取得，发明专利权属清晰，并处于有效期内，不存在权利受限或诉讼纠纷情况，相关发明专利直接应用于发行人主营业务产品的研发、设计、生产环节。基于上述，保荐机构认为，发行人形成主营业务收入的发明专利数量真实、准确，符合形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）5 项以上的指标。

4、保荐机构访谈了发行人管理层及财务负责人，取得了发行人报告期内的销售合同或订单，了解了发行人营业收入确认政策，访谈并函证了发行人主要客户，核查了报告期内发行人营业收入确认相关的会计记录及会计凭证，对发行人营业收入内部控制制度的有效性以及报告期各期营业收入的真实性、准确性、完整性以及截止情况进行了测试，查阅了发行人会计师出具的审计报告。经核查，发行人报告期内营业收入确认准确，营业收入增长情况真实。基于上述，保荐机构认为，发行人营业收入真实、准确，符合最近三年营业收入复合增长率达到 20% 以及最近一年营业收入金额达到 3 亿元的指标。

九、保荐机构关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的逐项说明

（一）发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“（一）符合中国证监会规定的发行条件”规定

1、保荐机构核查了发行人设立至今的营业执照、公司章程、发起人协议、创立大会文件、评估报告、审计报告、验资报告、工商档案等有关资料，发行人前身京仪有限成立于 2016 年 6 月，发行人于 2021 年 3 月按经审计账面净资产

产值折股整体变更为股份有限公司，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算，发行人持续经营时间在三年以上。

2、保荐机构查阅了发行人历次股东大会（股东会）、董事会、监事会会议文件，股东大会、董事会和监事会议事规则、独立董事工作制度、董事会秘书工作细则、董事会各专门委员会工作细则等相关制度文件，发行人依法建立健全了股东大会、董事会、监事会以及独立董事、董事会秘书制度。

因此，发行人本次发行符合《注册办法》第十条的规定。

3、经核查发行人的会计记录、财务报表以及记账凭证等资料，结合致同会计师出具的《审计报告》（致同审字（2023）第 110A010296 号，以下简称“审计报告”），保荐机构认为，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告。

4、经核查发行人的内部控制流程及内部控制制度，结合致同会计师出具的标准无保留意见的《内部控制鉴证报告》（致同专字（2023）第 110A007509 号），保荐机构认为，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具了无保留结论的内部控制鉴证报告。

因此，发行人本次发行符合《注册办法》第十一条的规定。

5、经核查发行人业务经营情况、主要资产、专利、商标等资料，实地核查有关情况，并结合发行人律师出具的法律意见书、直接控股股东及间接控股股东出具的声明文件及对发行人董事、监事和高级管理人员的调查表等资料，保荐机构认为，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与直接控股股东、间接控股股东及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册办法》第十二条第（一）项的规定。

6、经核查发行人报告期内的主营业务收入构成、重大销售合同及主要客户等资料，保荐机构认为发行人最近两年内主营业务未发生重大不利变化；经核

查发行人工商档案及聘请董事、监事、高级管理人员的股东大会（股东会）决议和董事会决议、核心技术人员签订的《劳动合同》以及访谈文件等资料，保荐机构认为，最近两年内发行人董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化。经核查发行人工商档案、控股股东承诺等资料，结合发行人律师出具的法律意见书，保荐机构认为，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近两年实际控制人为北京市国资委，最近两年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《注册办法》第十二条第（二）项的规定。

7、经核查发行人经营资料、重大借款合同、主要资产的权属证明文件、企业信用报告等资料，查询发行人涉及诉讼、仲裁情况，结合与发行人管理层的访谈、《审计报告》和发行人律师出具的法律意见书，保荐机构认为，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册办法》第十二条第（三）项的规定。

因此，发行人本次发行符合《注册办法》第十二条的规定。

8、发行人主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，主营产品包括半导体专用温控设备（Chiller）、半导体专用工艺废气处理设备（Local Scrubber）和晶圆传片设备（Sorter）。保荐机构查阅了发行人营业执照、公司章程、财务报告和审计报告，查阅了发行人所属行业的主要法律法规和规范性文件，对发行人高级管理人员、行业主管部门进行了访谈，并取得了相关政府部门出具的证明文件，认为发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。

9、根据发行人取得的工商、税务等机构出具的有关证明文件、控股股东提供的声明文件及发行人律师出具的法律意见书，保荐机构认为，最近三年内，发行人及其直接控股股东、间接控股股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

10、根据董事、监事和高级管理人员提供的无犯罪证明、调查表及中国证监会等网站公开检索等资料，结合发行人律师出具的法律意见书，保荐机构认为，发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

因此，发行人本次发行符合《注册办法》第十三条的规定。

综上，保荐机构认为，发行人符合中国证监会规定的发行条件，符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条第（一）项的规定。

（二）发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元”规定

经核查，发行人本次发行前股本总额为 12,600 万元，本次拟发行股份不超过 4,200 万股（未考虑本次发行的超额配售选择权），发行后股本总额不超过 16,800 万元。

（三）发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25% 以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10% 以上”规定

经核查，本次发行后，公司本次拟发行股份占发行后总股本的比例不低于 25%。

（四）发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“（四）市值及财务指标符合本规则规定的标准”规定

结合自身情况，发行人本次发行上市申请适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第（一）项的规定，即预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。

经核查致同会计师出具的《审计报告》，发行人 2022 年度营业收入为 6.64 亿元，2022 年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润为

8,202.21 万元，最近一年净利润为正。保荐机构认为，发行人符合《科创板上市规则》第 2.1.2 条第（一）项规定的财务指标标准。

结合发行人报告期股权融资情况和可比公司在境内市场的估值情况，保荐机构对发行人本次证券发行后市值进行了预先评估，预计发行人本次证券发行后市值不低于 10 亿元。保荐机构认为，发行人符合《科创板上市规则》第 2.1.2 条第（一）项规定的市值标准。

综上，保荐机构认为，发行人市值及财务指标符合《科创板上市规则》规定的标准，符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条第（四）项的规定。

（五）发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“（五）上海证券交易所规定的其他上市条件”规定

经核查，保荐机构认为，发行人符合上海证券交易所规定的其他上市条件，符合《科创板上市规则》第 2.1.1 条第（五）项的规定。

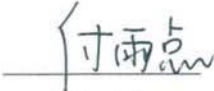
十、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排

主要事项	具体计划
(一) 持续督导事项	证券上市当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度
1、督导发行人有效执行并完善防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度	(1) 督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止主要股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；(2) 与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
2、督导发行人有效执行并完善防止其高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	(1) 督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；(2) 与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	(1) 督导发行人有效执行《公司章程》、《关联交易管理制度》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交易的信息披露制度；(2) 督导发行人及时向保荐机构通报将进行的重大关联交易情况，并对关联交易发表意见
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	(1) 督导发行人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务；(2) 在发行人发生须进行信息披露的事件后，审阅信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	(1) 督导发行人执行已制定的《募集资金管理制度》等制度，保证募集资金的安全性和专用性；(2) 持续关注发行人募集资金的专户储存、投资项目的实施等承诺事项；(3) 如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构，并督导其履行相关信息披露义务
(二) 保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	(1) 定期或者不定期对发行人进行回访、查阅保荐工作需要的发行人材料；(2) 列席发行人的股东大会、董事会和监事会；(3) 对有关部门关注的发行人相关事项进行核查，必要时可聘请相关证券服务机构配合
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	(1) 发行人已在保荐协议中承诺配合保荐机构履行保荐职责，及时向保荐机构提供与本次保荐事项有关的真实、准确、完整的文件；(2) 接受保荐机构尽职调查和持续督导的义务，并提供有关资料或进行配合
(四) 其他安排	无

(以下无正文)

(此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京京仪自动化装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签章页)

项目协办人：


付雨点

保荐代表人：


姚涛


黄祥

内核负责人：


刘益勇

保荐业务负责人：


王松

总经理（总裁）：


王松

法定代表人/董事长：


贺青

国泰君安证券股份有限公司

2023年7月26日